

長期インターンシップ申請書

200X年 ○月 ○日

申請者 フリガナ ハンダイ タロウ
氏名 阪大 太郎 印
(年齢 ○○歳)

現住所 箕面市小野原東○-△-□
(〒 562-00XX) (電話 0XX-XXXX-XXXX)

所属 電気電子情報工学専攻・○○研究室・博士後期課程 2年
(専攻・研究室・学年/職)

所在地 吹田市山田丘 2-1 大阪大学大学院 工学研究科
(〒565-0871) (電話 06-6879-XXXX 内線 XXXX)
(E-mail : xxxx@xx.eei.eng.osaka-u.ac.jp)

IDER ユニット名 次世代○○デバイスの□□ユニット

ユニットリーダー ○○研究室 准教授 □□ □□ 印
(所属・役職・氏名)

指導教員 ○○研究室 教授 ○○ ○○ 印
(所属・役職・氏名)

次のとおり長期インターンシップを申請します。

受入機関名

Handai Power Electronics Technology (アメリカ ウィスコンシン州)

インターンシップ内容

パワーエレクトロニクス回路の設計と実装に関する業務

希望助成金額

40 万円 (交通費往復等)

派遣期間

(3ヶ月以上)

200X年 12月 1日～ 200X年 2月 29日 (約 3ヶ月)

添付資料

1. 審査資料
2. インターンシップ計画表 (形式自由)
3. インターンシップ受け入れを証明するもの (電子メール等)
4. インターンシップ内容の参考資料 (受け入れ先からの書類等)
5. 申請額内訳

事務局記入欄	選考日	年	月	日	助成金額	円
--------	-----	---	---	---	------	---

審 査 資 料

No. _____

フリガナ 氏 名 ハンダイ タロウ 阪大 太郎 (学年/職 博士後期課程 2 年)	所属専攻・研究室 電気電子情報工学専攻 ○○研究室 RA支援等の有無 (<input checked="" type="radio"/> 有 無)
受入機関名・部署 Embedded Power System, Handai Power Electronics Technology	
受入担当者氏名・職・連絡先 Dr. Bill Weeks, General Manager Tel xxx/xxx-xxxx Fax xxx/xxx-xxxx E-mail xxx@xxx.xxx.xxx.com	
受入機関所在地 ○—○ ** Street, Madison, WI 53706-1691, U.S.A	
滞在先住所・連絡先 ○—○ Apartment, ** Street, Madison, WI 53706-1691, U.S.A Tel xxx/xxx-xxxx Fax xxx/xxx-xxxx E-mail xxx@xxx.xxx.xxx.com	
派遣期間 200X 年 12 月 1 日 ~ 200X 年 2 月 29 日 (約 3 ヶ月)	
受入機関からの支援 (<input checked="" type="radio"/> 有 無) *有の場合は具体的に金額等記してください *有の場合は具体的な支援内容・金額等を記入してください。 \$ 500 / Week の手当(住居手当含む)がある。	
インターンシップ目的・内容 米国で回路実装技術に定評がある Handai Power Electronics Technology 社の回路実装部門に配属し、回路実装の設計・技術について実習を通じて学ぶ。具体的には、(1) 高出力電源の実装技術、(2) EMI 対策のノウハウ、(3) CAD による設計、等について約 3 か月にわたって実習を行う予定である。 そのほか、1 ヶ月に 1 回レポートを社に提出する必要がある。また 2 月には 3 日間の教育研修に参加する予定となっている。 <特記事項> Handai Power Electronics Technology 社は、○○研究室と共同研究を行っている。 (注:本「審査資料」の他、「インターンシップ計画表」、「インターンシップ受け入れを証明するもの(電子メール等)」、「インターンシップ内容の参考資料」、「申請額内訳資料(交通費等)」を添付してください)	